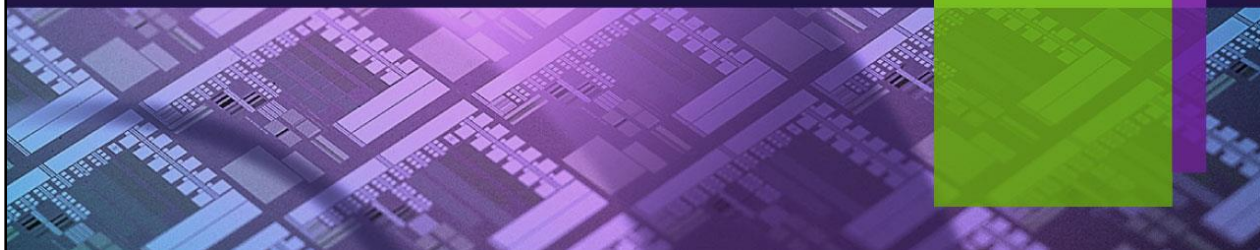


2026年3月期 第3四半期（2025年10月～12月） 東京エレクトロン 決算説明会

2026年2月6日

内容：

- 連結決算の概要 川本 弘 （常務執行役員 ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー）
- 事業環境および業績予想 河合 利樹 （代表取締役社長・CEO）



将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、政治経済情勢、半導体市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権、感染症の影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。

2026年3月期 第3四半期 連結決算の概要

2026年2月6日

常務執行役員 ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー
川本 弘



改めまして、川本でございます。
私から、2026年3月期、第3四半期 連結決算の概要 をご説明いたします。

損益状況（四半期）

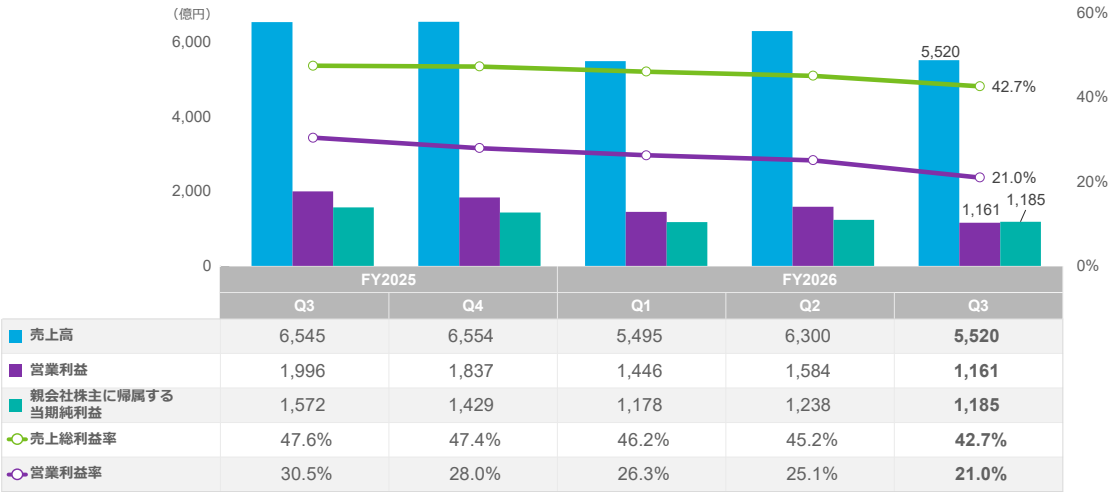
(億円)

	FY2025		FY2026			vs. FY2026 Q2	vs. FY2025 Q3
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3		
売上高	6,545	6,554	5,495	6,300	5,520	-12.4%	-15.7%
売上総利益	3,117	3,105	2,539	2,848	2,358	-17.2%	-24.4%
売上総利益率	47.6%	47.4%	46.2%	45.2%	42.7%	-2.5pts	-4.9pts
販管費	1,121	1,267	1,092	1,264	1,196	-5.3%	+6.7%
営業利益	1,996	1,837	1,446	1,584	1,161	-26.7%	-41.8%
営業利益率	30.5%	28.0%	26.3%	25.1%	21.0%	-4.1pts	-9.5pts
税金等調整前当期純利益	2,001	1,851	1,519	1,610	1,533	-4.8%	-23.4%
親会社株主に帰属する当期純利益	1,572	1,429	1,178	1,238	1,185	-4.3%	-24.6%
研究開発費	618	727	621	726	662	-8.9%	+7.2%
設備投資額	502	346	528	912	303	-66.7%	-39.6%
減価償却費	160	183	171	191	211	+10.6%	+31.7%

1. 当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。
3. FY2025は2024年4月～2025年3月の会計年度を指しています。FY2026は2025年4月～2026年3月の会計年度を指しています。

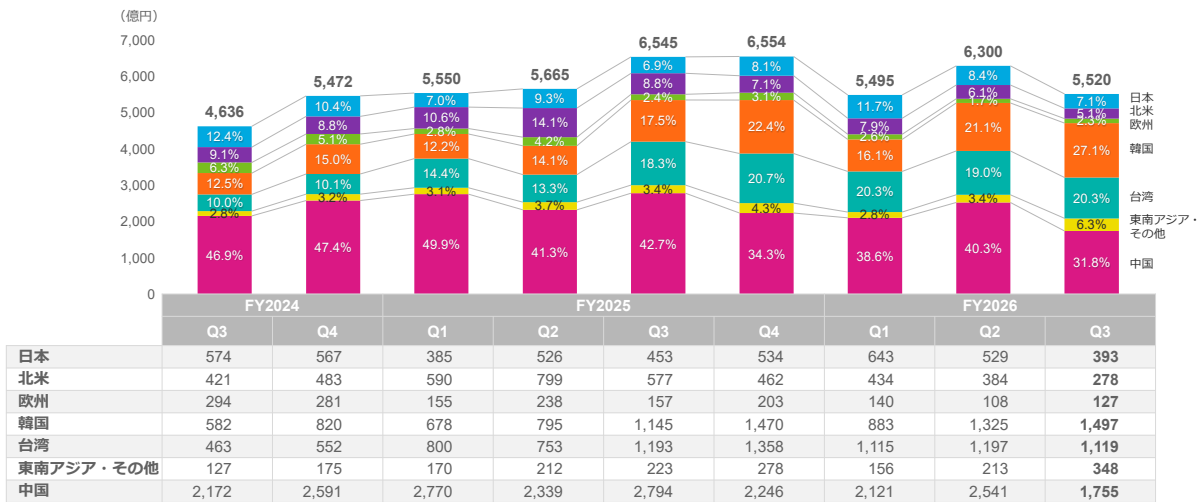
こちらは、四半期ごとの「損益状況」です。
青枠の部分を中心にご覧ください。
第3四半期の売上高は、前四半期比 12.4%減少の 5,520億円となりました。
第3四半期は、出荷のタイミング等もあり一時的に低水準な結果となりました。
計画通り、第4四半期は売上増加を見込んでおりますことを補足させていただきます。
売上総利益は、前四半期比17.2%減少の2,358億円。
売上総利益率は、プロダクトミックスの変化等により、前四半期比2.5ポイント減少の42.7%となりました。
営業利益は、前四半期比26.7%減少の、1,161億円。
営業利益率は、主に売上高の減少に伴う固定費比率の増加により、前四半期比4.1ポイント減少の21.0%となりました。
税金等調整前当期純利益は、前四半期比4.8%減少の1,533億円、親会社株主に帰属する当期純利益は、前四半期比 4.3%減少の1,185億円となりました。
なお、第3四半期に政策保有株式を売却しており、372億円の特別利益を計上いたしました。
また、第3四半期の設備投資額は303億円でした。

損益状況（四半期）



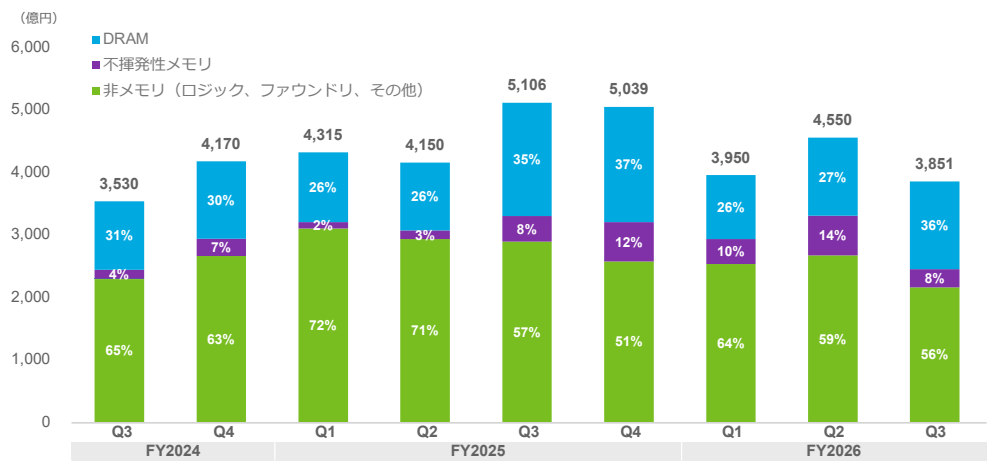
こちらのグラフは、先ほどご説明させていただいた業績を時系列で示しておりますので、ご確認ください。

地域別売上高構成比（四半期）



こちらは、「地域別売上高」です。
第3四半期の構成比につきましては、韓国で前四半期比6ポイント増加し27.1%となりました。
一方で、中国向けの売上高構成比は低下し、前四半期比8.5ポイント減少の31.8%となりました。

SPE新規装置 アプリケーション別売上構成比（四半期）

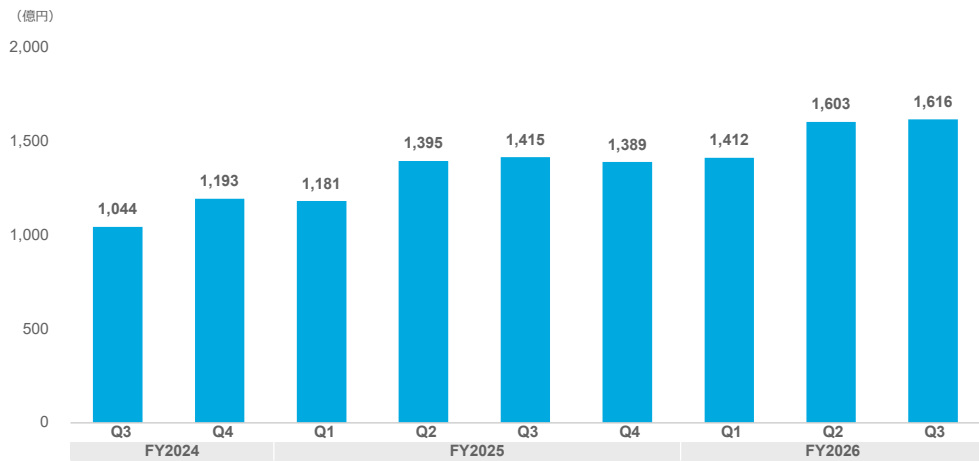


1. SPE (Semiconductor Production Equipment) : 半導体製造装置
2. グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれていません。

こちらは、「SPE新規装置のアプリケーション別 売上構成比」です。
第3四半期の構成比は、下から非メモリが 56%、不揮発性メモリが 8%、DRAMが 36%となりました。

SPE新規装置の売上額は 前四半期より減少しましたが、DRAM向けは前四半期比 12%増加と堅調に推移いたしました。

フィールドソリューション売上高（四半期）

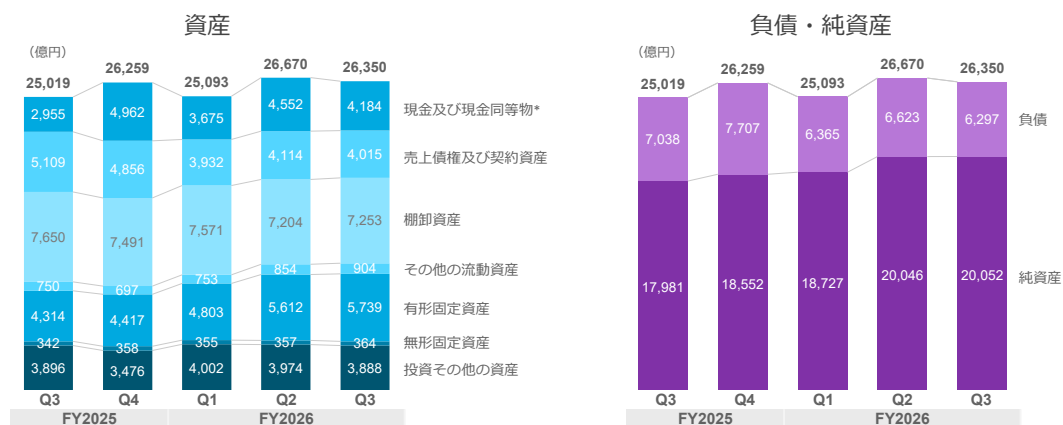


こちらは、「フィールドソリューションの売上高」です。

第3四半期は、1,616億円となりました。

お客様の稼働率が高まっており、スペアパーツ等が堅調に推移したほか、第2四半期に続き、改造案件も高水準を維持いたしました。

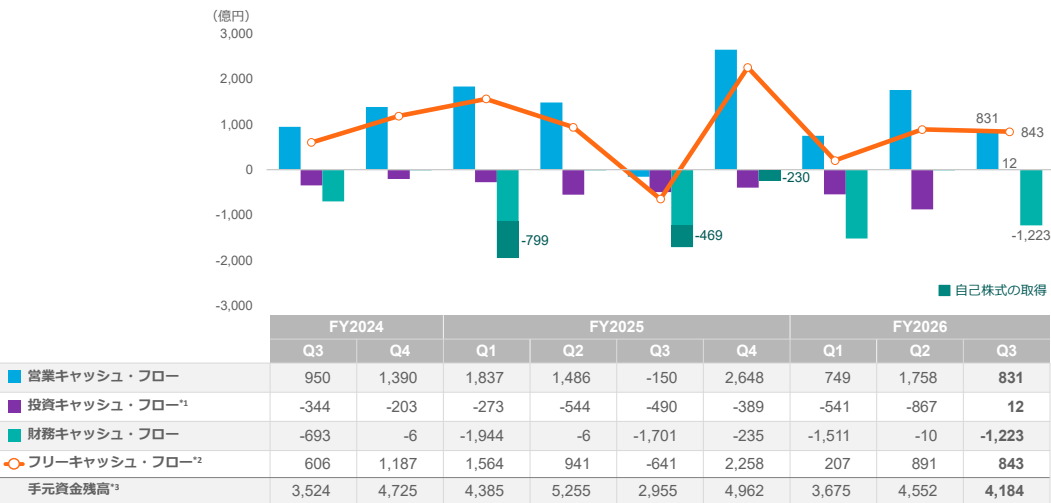
貸借対照表（四半期）



*現金及び現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

続きまして、「貸借対照表」をご説明いたします。
資産合計は、2兆6,350億円となりました。
現金同等物は、4,184億円。前四半期から367億円減少いたしました。
売上債権及び契約資産は、前四半期比98億円減少の4,015億円。
棚卸資産は、前四半期比49億円増加の7,253億円。
有形固定資産は、前四半期から126億円増加し、5,739億円となりました。
続いて、右側の負債・純資産でございますが、負債は、前四半期から326億円減少の6,297億円となりました。
純資産は、前四半期比6億円増加の2兆52億円となりました。

キャッシュ・フロー（四半期）



^{*1} 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。
^{*2} フリーキャッシュ・フロー＝営業キャッシュ・フロー＋投資キャッシュ・フロー（定期預金および短期投資の増減を除く）
^{*3} 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3カ月を超える定期預金および短期投資の合計額です。

続きまして、「キャッシュ・フロー」をご説明いたします。
この四半期における営業キャッシュフロー獲得は、831億円でした。
投資キャッシュフローは、有形固定資産の取得や投資有価証券の売却等の結果、12億円の収入となりました。
財務キャッシュフローの支出は、主に、配当金の支払いにより、1,223億円。
また、フリーキャッシュフローは、843億円の収入となりました。
私からのご説明は以上です。ありがとうございました。

事業環境および業績予想

2026年2月6日

代表取締役社長・CEO
河合 利樹



河合でございます。

改めまして、本日はご参加いただきありがとうございます。

私からは、「事業環境 および 業績予想」について、ご説明致します。

事業環境（2026年2月時点でのWFE市場の見方）

- CY2026：15%以上の成長を見込む
 - AIサーバー向け半導体需要の急速な拡大に伴い、先端ロジックとDRAM投資が大幅に増加
 - 変動要因：顧客工場のクリーンルームスペース、納期（部材供給、労働力）、為替など
- 今後も旺盛なAIアプリケーション需要に牽引され、先端半導体向け投資は中長期的に拡大傾向が続くと見込む
 - DRAM：HBMのみならず汎用DRAM向け投資も急増。投資前倒し要求も強い
 - NAND：SSD向け需要が急増。稼働率も上昇し新規投資につながる勢い
 - ロジック/ファウンドリ：先端向け投資は今後もさらに増加。
アドバンストパッケージングも進展
 - 成熟世代デバイス：現状と同規模程度のWFEが継続すると予測

付加価値の高い最新装置の需要拡大を見込む

まず、事業環境についてです。

CY2026のWFE市場は、現時点では、前年比 15%以上の成長を見込んでおります。お客様のクリーンルームのスペースや、SPEメーカーの部材調達の状況、生産労働力への対応等は、確認していく必要がありますが、足元の強い引き合いを考慮しますと、前年比 20%以上の成長も期待できる勢いです。

今後も、AIアプリケーション需要の成長によって、先端半導体向けの投資は、技術革新を伴いながら、中長期的に拡大が続くと見えています。

DRAMは、HBM向けのみならず、汎用DRAM向け投資も急増しているため、需給が逼迫し、装置の前倒し納入の要求を多くいただいております。

NANDも、データセンター向けのSSD、いわゆる、eSSDの需要の高まりと共に、お客様の工場稼働率が上昇しており、新規投資につながる勢いです。

ロジックは、2nm、そして1.4nmへと微細化を伴いながら、今後も更に投資が増加します。先端パッケージングやテストのニーズも日増しに加速しており、その重要性は高まる一方です。

また、成熟世代向けは、現状と同規模程度の投資が継続すると予測しています。

これらを背景に、CY2026のWFE市場は、過去最高を更新し、少なくとも、130Bドルを越す市場規模となる見込みです。

先端エリアで拡大する事業機会

* POR (Process of Record) : 顧客の半導体製造プロセスにおける装置採用の認定

エッチング	<ul style="list-style-type: none">・ HBM 配線工程POR、キャパシタ工程 大手POR独占 (DRAM)・ Slit工程、チャネルホール工程 POR (NAND)・ アドバンストパッケージ向け POR (ロジック)
塗布現像	<ul style="list-style-type: none">・ メタルオキシドレジスト対応 究極のウェット現像技術評価進捗・ 新製品CLEAN TRACK™ LITHIUS Pro DICE™リリース
成膜	<ul style="list-style-type: none">・ アドバンストパッケージ向けキャパシタHigh-k POR (ロジック)・ 埋め込み膜用 枚葉プラズマCVD 評価開始 (ロジック)・ 新低抵抗メタル ワードライン工程POR (NAND)
洗浄	<ul style="list-style-type: none">・ 次世代超臨界装置、複数顧客において評価開始 (DRAM)・ レジスト剥離 複数顧客で評価中、1社POR獲得済 (ロジック/メモリ)・ パッチ + 枚葉のハイブリッド装置評価開始 (ロジック/メモリ)
プローバ	<ul style="list-style-type: none">・ AI/HPC向け先端Logicで市場を席捲。プローバ全体でFY2027売上1,000億円超・ ダイブローバ、複数顧客で評価開始。4月リリース予定
ボンダー / レーザー	<ul style="list-style-type: none">・ ボンダー : HBM薄化向け、NANDメモリセル+周辺回路、ロジック裏面配線、アドバンストパッケージ向け POR・ レーザリフトオフ・トリミング、複数顧客にてプロセス評価進捗・ ボンダー/レーザー売上 今後5年で5,000億円以上を見込む
ディスプレイ	<ul style="list-style-type: none">・ エッチング シェア80%以上、IT OLED向け高付加価値製品投入

先端アプリケーション装置における展開とともに、
AI関連需要によるフィールドソリューションの事業機会も拡大

Investor Relations / February 6, 2026



13

AIサーバーを中心とするハイエンドデバイス向けのWFEは、CY2030にかけてCAGR10%の市場成長が期待されます。

さらなる微細化、高積層化、高性能化が求められる中、当社においては、エッチング、塗布現像、成膜、洗浄の製品領域で、当会計年度だけでも、ご覧のような大きな進捗がありました。

また、テスト・アドバンストパッケージングのエリアも成長が著しく、来期は、プローバ全体で 1,000億円以上の売上が期待されるほか、中工程とも呼ばれるボンダーやレーザー関連装置など、三次元実装のエリアでも、CY2030までに累計 5,000億円以上の売上を見込んでいます。

ディスプレイ向けのエッチングにおいても、シェアが 80%以上となるなど、大きな営業機会になっています。

こうした装置の事業機会の広がりに加え、お客様における工場稼働率の上昇により、フィールドソリューションの機会も拡大しています。

事業進捗

- 生産性と環境性能を向上させる新製品2種リリース
 - CLEAN TRACK™ LITHIUS Pro DICE™:
世界最高クラスの生産性と革新的な欠陥制御技術を備えた最新鋭の塗布現像装置
 - EVAROS™:
最大処理能力200枚、高精度・高品質な成膜コントロールを叶えたCVD/ALD装置
- Clarivate Top 100 グローバル・イノベーター 2026受賞
 - 高度な発明を継続的に生み出していることが評価され、5年連続 6度目の受賞
 - 半導体製造装置業界で世界1位を誇る保有特許件数：26,029件（2025年末時点）

革新的で付加価値の高い独自の技術を継続的に創出するべく、
積極的な研究開発投資を実施

これまで、半導体デバイスの市場規模は、CY2030で1兆ドルに成長する、というのが業界のコンセンサスでしたが、昨年12月に発表された最新のWSTSの統計によると、今年CY2026には「9,750億ドル」と、ほぼ1兆ドルが見えてきており、市場成長が加速しています。

このように大きな市場成長が期待できる中、昨年12月のSEMICON Japanにおいて、生産性と環境性能を向上させる、新製品を2機種、リリースいたしました。

世界シェア 90%以上を誇る塗布現像装置をさらに進化させ、世界最高クラスの生産性と、革新的な欠陥制御技術を備えた最新鋭 装置「CLEAN TRACK LITHIUS PRO DICE」、こちらは既に、EUV向けを含む複数のお客様に納入を開始しています。

熱処理成膜装置「EVAROS」は、新マルチゾーン制御ヒーターにより、高い均熱性と、昇降温時間の大幅な短縮を可能としました。

1回あたり最大 200枚のウェーハを処理する能力と、搬送時間の短縮により、さらなる生産性の向上を実現します。

また、ウェーハ1枚あたりのCO₂排出量は、従来比 25%の削減が可能です。

さて、当社が保有する特許数は、昨年末時点で 26,029件と、半導体製造装置業界で世界1位を誇っております。

この度、高度な発明を継続的に生み出していることが評価され、Clarivate社による「Top100 グローバルイノベーター2026」を受賞することができました。5年連続、6度めの受賞となります。

今後も、革新的で付加価値の高い「オンリーワン」、「ナンバーワン」技術の継続的な創出に向け、積極的な研究開発投資を実施してまいります。

2026年3月期 業績予想

(億円)

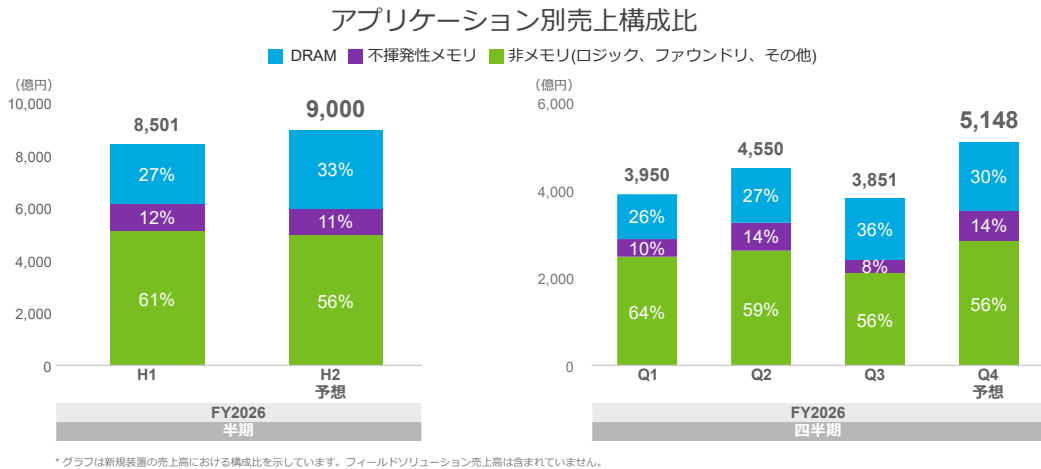
	FY2025 (実績)	FY2026					ご参考：FY2026 10/31時点予想	
		H1 (実績)	H2 (新予想)	通期 (新予想)	vs FY2025	通期修正額*	H2	通期
売上高	24,315	11,796	12,303	24,100	-0.9%	300	12,003	23,800
売上総利益	11,462	5,388	5,531	10,920	-4.7%	130	5,401	10,790
売上総利益率	47.1%	45.7%	45.0%	45.3%	-1.8pts	-	45.0%	45.3%
販管費	4,489	2,357	2,632	4,990	+11.1%	60	2,572	4,930
研究開発費	2,500	1,348	1,551	2,900	+16.0%	-	1,551	2,900
研究開発費以外の販管費	1,989	1,009	1,081	2,090	+5.1%	60	1,021	2,030
営業利益	6,973	3,031	2,898	5,930	-15.0%	70	2,828	5,860
営業利益率	28.7%	25.7%	23.6%	24.6%	-4.1pts	-	23.6%	24.6%
税金等調整前当期純利益	7,061	3,129	4,010	7,140	+1.1%	790	3,220	6,350
親会社株主に帰属する当期純利益	5,441	2,416	3,083	5,500	+1.1%	620	2,463	4,880
1株当たり当期純利益 (円)	1,182.40	527.31	-	1,200.05	+17.65	135.28	-	1,064.77

* 2025年10月31日に発表した通期業績予想からの修正額を示しています。

力強い事業環境を踏まえ、通期の業績予想を上方修正。
政策保有株式の追加売却に伴う特別利益も反映

次に、業績予想についてです。
昨今の力強い事業環境を踏まえ、FY2026通期の業績予想を上方修正いたしました。
ご覧のとおり、売上高 2兆 4,100億円、売上総利益率 45.3%、営業利益率 24.6%を見込んでおります。
また、第4四半期においても、政策保有株式を追加で売却することを決定いたしました。
これも踏まえ、親会社株主に帰属する当期純利益は 5,500億円となる見込みです。

2026年3月期 SPE新規装置売上予想



* グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高は含まれていません。

FY2026 H2のSPE新規装置売上予想を9,000億円に更新。
Q4の新規装置売上はQ3比 +30%以上を見込む

こちらは、今期 FY2026の SPE新規装置の売上予想を、アプリケーション別を示しております。

今下期の予想につきましては、旺盛なAIサーバー向けの需要を背景に、9,000億円に更新いたしました。

ご覧のとおり、第4四半期におけるSPE新規装置売上は、ロジック、ファウンドリ向けを主として、第3四半期と比べて、30%以上、伸びる見込みです。

2026年3月期 研究開発費・設備投資計画

宮城 第3開発棟
エッチング装置



宮城県黒川郡
2025年4月 竣工

東北生産・物流センター
成膜装置



岩手県奥州市
2025年11月 竣工

熊本 プロセス開発棟
コート/デベロッパ、洗浄装置

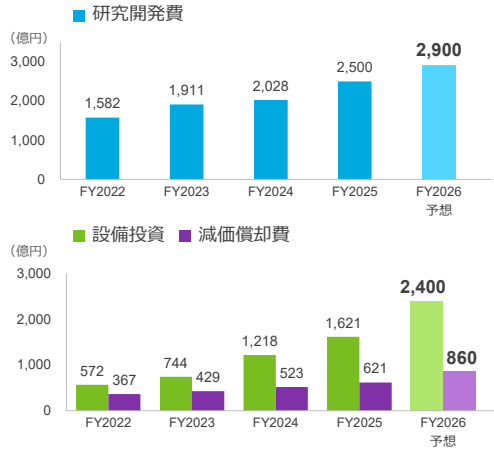


熊本県合志市
2025年10月 竣工

宮城生産革新センター
エッチング装置



宮城県黒川郡
2027年夏 竣工予定

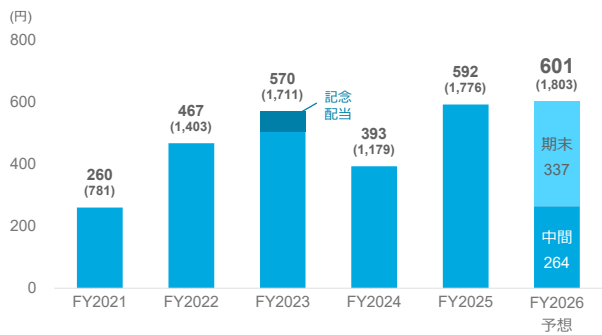


半導体の技術革新を支える対応力と急速な需要拡大に応える生産能力を確立。
今後の収益機会を着実に捉え、企業価値の最大化を目指す

次に、「研究開発費と設備投資の計画」についてです。
4月に竣工した宮城の新開発棟、10月に竣工した熊本の新開発棟に続き、11月には岩手の生産・物流センターも、竣工しました。
次世代のスマートプロダクション構想を採り入れた、宮城の生産新棟も 来年夏に竣工予定です。
FY2026の 研究開発費および設備投資計画は、ご覧のとおりです。2025年10月の決算発表から変更はございません。
当社は、これらの成長投資を計画通り実施したことで、半導体の技術革新を支える対応力と急速な需要拡大に応える生産能力を実装し、今年、CY2026の大きな市場成長の波に乗ることができると、考えております。
この強固な基盤を活用し、今後の収益機会を着実に捉え、企業価値を最大化してまいります。

2026年3月期 配当予想

1株当たり配当金



- FY2021～2023の1株当たり配当額は、FY2021の期首に株式分割がおこなわれたと仮定した金額を記載しています。
- FY2023には60周年記念配当が含まれます。
- 株式分割がおこなわれる以前の金額を（ ）内で記載しています。

当社の株主還元策

連結配当性向：50%

但し、1株当たり年間配当金50円*を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得：機動的に実施を検討

*2023年4月1日付の株式分割により、従来の150円から変更しています。

1株当たり通期配当予想は過去最高の601円に上方修正

次に、「配当予想」についてです。
業績予想の修正を加味し、1株当たりの配当予想は、533円から68円増額し、過去最高となる通期 601円に上方修正いたします。

自己株式の取得について

最大1,500億円の自己株式取得を予定

- 取得対象株式の種類 : 当社普通株式
- 取得し得る株式の総数 : 750万株（上限）
(自己株式を除く発行済株式総数に対する割合 1.6%)
- 株式の取得価額の総額 : 1,500億円（上限）
- 取得する期間 : 2026年2月9日～2026年3月31日

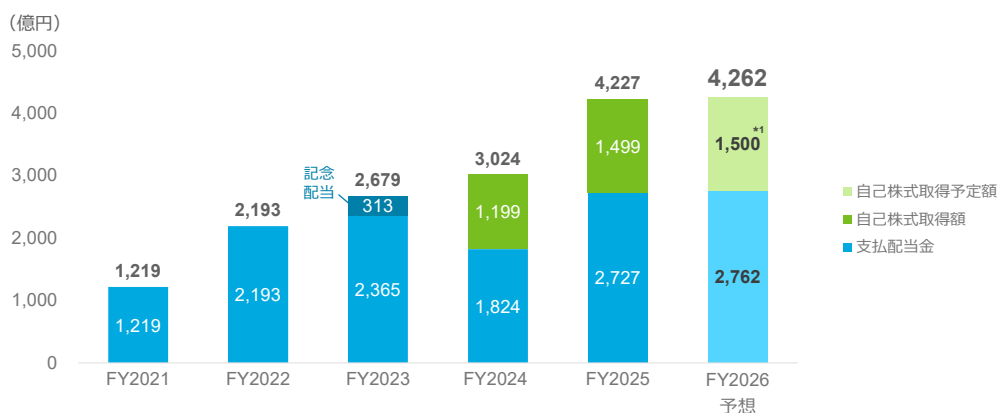
拡大する当社の事業機会とキャッシュ創出力、資本効率の向上を考慮し、
今後も適切なバランスシート・マネジメントを実施

また、本日の取締役会において、1,500億円を上限として自己株式を取得することを決定いたしました。

今回の決定は、拡大する当社の事業機会から想定される、来期の当社のキャッシュ創出力、および、キャッシュポジションや資本効率の向上等を総合的に勘案したことによるものです。

今後も、適切なバランスシート・マネジメントをおこなってまいります。

総還元額



*1 https://www.tel.co.jp/news/ir/2026/g5nrme00000000lw-att/02062026_002.pdf

自己株式取得と合わせ、過去最高の総還元額を見込む

こちらは最後のスライド、「総還元額の推移」になります。

今期の総還元額は、先程ご説明した 配当予想と、本日発表した自己株式の取得を合わせ、4,262億円 と、前期を上回り、過去最高の 総還元額になる見込みです。

私からのご報告は以上となります。ご清聴ありがとうございました。



ご案内：東京エレクトロン主催スモール会議

機関投資家・アナリスト向け

2026年3月期第3四半期決算説明会のフォローアップセッション

■ 日時：

- 日本語： 2026年2月19日(木) 10:30 - 11:30 (日本時間)
- 英語： 2026年2月20日(金) 8:00 - 9:00 (日本時間)

■ スピーカー：

- IR室グローバルヘッド 八田浩一、室長 高木純子

■ 形式：

- ウェビナー

■ 事前登録ページ：

- https://app.msetsu.com/stocks/8035/ir_events

